

## 日月光九十九年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 99 年 4 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈九十九年度第一季獲利報告，本公司九十九年第一季之合併營業收入較九十八年第四季成長 43%，較九十八年同期成長 180%，為新台幣 37,555 百萬元。茲將日月光九十九年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第一季	98 年度 第四季	98 年度 第一季
營業收入	37,555	26,293	13,397
營業毛利	7,556	6,607	658
營業淨利(淨損)	4,279	3,962	(1,411)
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,073	3,972	(1,646)
所得稅利益(費用)	(455)	(418)	50
少數股權純損(益)	(223)	(104)	29
本期淨利(淨損)	3,395	3,450	(1,567)
稀釋每股盈餘(元)	0.63	0.66	(0.3)

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第一季	98 年度 第四季	98 年度 第一季
營業收入	27,423	26,293	13,397
營業毛利	6,447	6,607	658
營業淨利(淨損)	3,818	3,962	(1,411)
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	3,931	3,972	(1,646)
所得稅利益(費用)	(395)	(418)	50
少數股權純損(益)	(141)	(104)	29
本期淨利(淨損)	3,395	3,450	(1,567)
稀釋每股盈餘(元)	0.63	0.66	(0.3)

### 半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	45
個人電腦	17
汽車及消費性電子產品	38
其他	0
前十大客戶佔營收比重	44

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	50
歐洲	12
台灣	23
日本	10
亞洲其他地區	5

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	87
Traditional leadframe based	6
Module assembly	4
Others	3
封裝資本支出金額	137 百萬美元
打線機台數	9,817 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	83
晶圓測試	14
前段測試	3
測試資本支出金額	43 百萬美元
測試機台數	1,634 台

### 環隆電氣之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
電腦暨週邊產品	25
通訊產品	21
網路儲存暨伺服器產品	9
微電子構裝技術暨製造服務	28
工業暨汽車電子產品	17
前十大客戶佔營收比重	79
EMS 資本支出金額	9 百萬美元